

积层陶瓷电容器

TDK 扩展车载等级直插式低电阻 MEGACAP（带金属框架）电容器产品阵容

- 车载等级直插式 MEGACAP 电容器，符合 AEC-Q200 车载标准
- 通过优化金属框架材料实现低电阻
- 产品阵容包括 99 nF/1000 V（1 类电介质）和 47 μ F/100 V（2 类电介质）

2024 年 9 月 10 日

TDK 株式会社（TSE: 6762）进一步扩大了其车载等级 CA 系列 MEGACAP（带金属框架）电容器产品阵容。该系列产品于 2024 年 9 月开始量产。

近年来，混合动力汽车（HEV）和纯电动汽车（BEV）等电动动力系统汽车以及高效充电技术的发展取得了显著进展，两者都有助于减少温室气体排放。在这些应用场景中，逆变器、车载充电器（OBC）及无线电力传输（WPT）系统等子系统的功耗不断增加，因此，MLCC 必须处理大电流并具有大电容。

为了满足上述需求，TDK 推出了 CA 系列——业内最大*的 3 层堆叠配置、带金属框架的 MLCC（6.00 x 5.60 x 6.40 毫米）。由此，TDK 现可提供广泛的产品阵容，包括 99 nF/1000 V（1 类电介质）和 47 μ F/100 V（2 类电介质）。

为了处理大电流，TDK 通过优化金属框架的材料，在原产品的基础之上进一步降低了等效串联电阻（ESR）。这有助于减少组件数量并促进设备小型化。今后，TDK 将继续扩大其产品阵容，以满足客户需求。

* 截至 2024 年 9 月，根据 TDK

主要应用

- 电源线路的平滑和去耦
- 车载充电器（OBC）和无线电力传输（WPT）等子系统和谐振电路
- 逆变器中的缓冲电路

主要特点与优势

- 通过优化金属框架材料实现低电阻
- 通过采用多个 MLCC 实现大电容，以助力减少组件数量，促进设备小型化
- 高可靠性，符合 AEC-Q200 车载标准

型号	外型尺寸 [mm] (长 x 宽 x 高)	型号	温度特性	额定电压 [V]	电容 [F]
CAA572C0G3A203J640LJ	6.00 x 5.60 x 6.40	2 层	C0G	1000	20 n
CAA572C0G3A303J640LJ	6.00 x 5.60 x 6.40	2 层	C0G	1000	30 n
CAA572C0G3A443J640LJ	6.00 x 5.60 x 6.40	2 层	C0G	1000	44 n
CAA572C0G3A663J640LJ	6.00 x 5.60 x 6.40	2 层	C0G	1000	66 n
CAA573C0G3A993J640LJ	6.00 x 8.40 x 6.40	3 层	C0G	1000	99 n
CAA572C0G2J204J640LJ	6.00 x 5.60 x 6.40	2 层	C0G	630	200 n
CAA573C0G2J304J640LJ	6.00 x 8.40 x 6.40	3 层	C0G	630	300 n
CAA572X7T2J105M640LJ	6.00 x 5.00 x 6.40	2 层	X7T	630	1 μ
CAA573X7T2J155M640LJ	6.00 x 7.50 x 6.40	3 层	X7T	630	1.5 μ
CAA572X6T2W225M640LJ	6.00 x 5.00 x 6.40	2 层	X6T	450	2.2 μ
CAA573X6T2W335M640LJ	6.00 x 7.50 x 6.40	3 层	X6T	450	3.3 μ
CAA572X7T2V225M640LJ	6.00 x 5.00 x 6.40	2 层	X7T	350	2.2 μ
CAA573X7T2V335M640LJ	6.00 x 7.50 x 6.40	3 层	X7T	350	3.3 μ
CAA572X7S2A336M640LJ	6.00 x 5.00 x 6.40	2 层	X7S	100	33 μ
CAA573X7S2A476M640LJ	6.00 x 7.50 x 6.40	3 层	X7S	100	47 μ
CAA572X7R1V107M670LJ	6.25 x 5.00 x 6.70	2 层	X7R	35	100 μ
CAA573X7R1V157M670LJ	6.25 x 7.50 x 6.70	3 层	X7R	35	150 μ
CAA572X7R1E107M670LJ	6.25 x 5.00 x 6.70	2 层	X7R	25	100 μ
CAA573X7R1E157M670LJ	6.25 x 7.50 x 6.70	3 层	X7R	25	150 μ

如有需要，您可以点击“型号”，进入产品页面，购买样品。



关于 TDK 公司

TDK 株式会社总部位于日本东京，是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK 建立在精通材料科学的基础上，始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技，吸引未来”，迎接社会的变革。公司成立于 1935 年，旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK 全面和创新驱动的产品组合包括无源元件，如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统（如：温度和压力、磁性和 MEMS 传感器）。此外，TDK 还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括 TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics 以及 TDK-Lambda。TDK 重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在 2024 财年，TDK 的销售总额为 146 亿美元，全球雇员约为 101,000 人。

请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片
https://www.tdk.com/zh/news_center/press/20240910_01.html

如欲获取更多有关本产品资料请点击
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_automotive_megacap_ca_zh.pdf

地区媒体联系方式

地域	负责人	所属	电话号码	邮件地址
Greater China	Ms.Clover XU	TDK China Co., Ltd.	+86 21 61962307	TDK.PR-CN@tdk.com